

2018年3月期 第1四半期（2017年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2017年7月27日

内容：

- 第1四半期連結決算の概要 代表取締役・CFO、専務執行役員 堀 哲朗
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第1四半期 連結決算の概要

2017年7月27日

堀 哲朗

代表取締役・CFO、専務執行役員



2018年3月期 第1四半期のハイライト

- 前年同期比で売上高884億円増加 (+60%)
営業利益326億円増加 (+148%)
- 売上総利益率40%以上、営業利益率23%以上と高水準を維持
期初計画に沿って進捗
- FPDセグメント利益率は減少するも、想定通り
通期ベースでの利益率は予定通り改善を見込む

FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

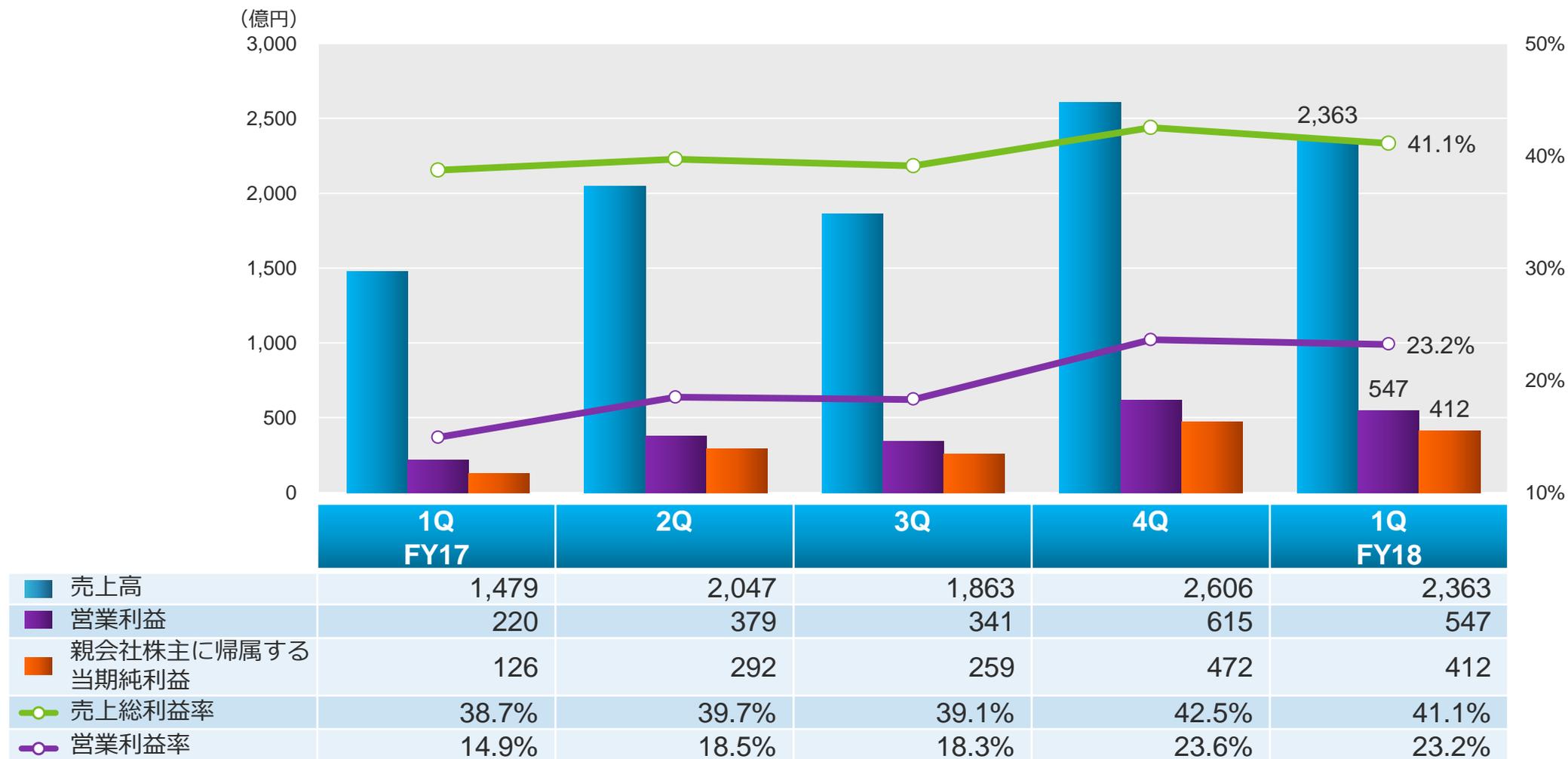
損益状況

(億円)

	2017年3月期				2018年3月期	対前年4Q 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
売上高	1,479	2,047	1,863	2,606	2,363	-9.3%
売上総利益 下段：売上総利益率	573 38.7%	813 39.7%	729 39.1%	1,106 42.5%	971 41.1%	-12.2% -1.4pts
販管費	352	434	387	491	423	-13.8%
営業利益 下段：営業利益率	220 14.9%	379 18.5%	341 18.3%	615 23.6%	547 23.2%	-11.0% -0.4pts
税前利益	161	382	332	614	551	-10.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	126	292	259	472	412	-12.8%
研究開発費	177	220	191	248	211	-14.6%
設備投資額	38	55	41	71	81	+13.5%
減価償却費	39	42	45	50	42	-16.7%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況



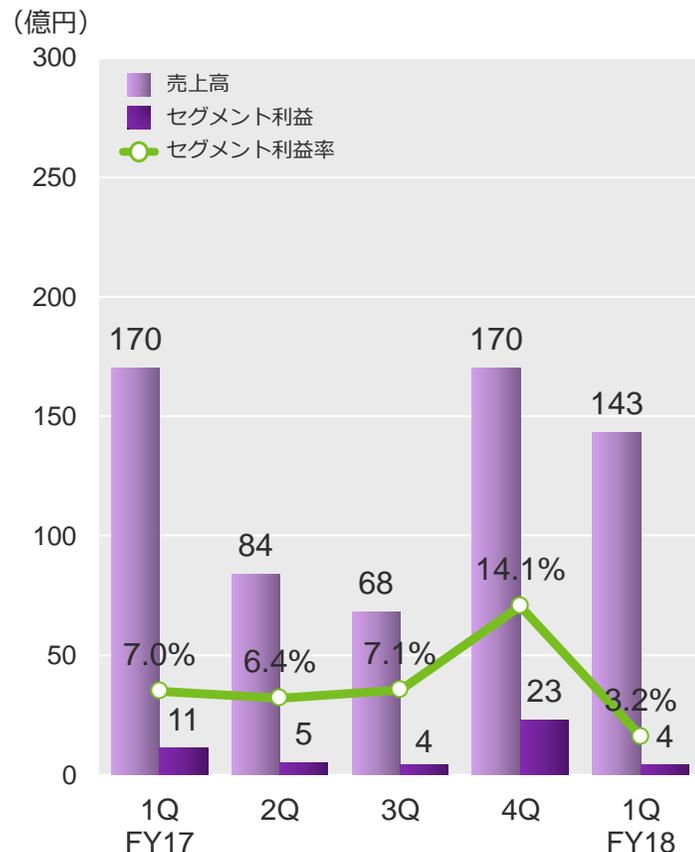
売上総利益率、営業利益率ともに高水準を維持

セグメント情報

SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



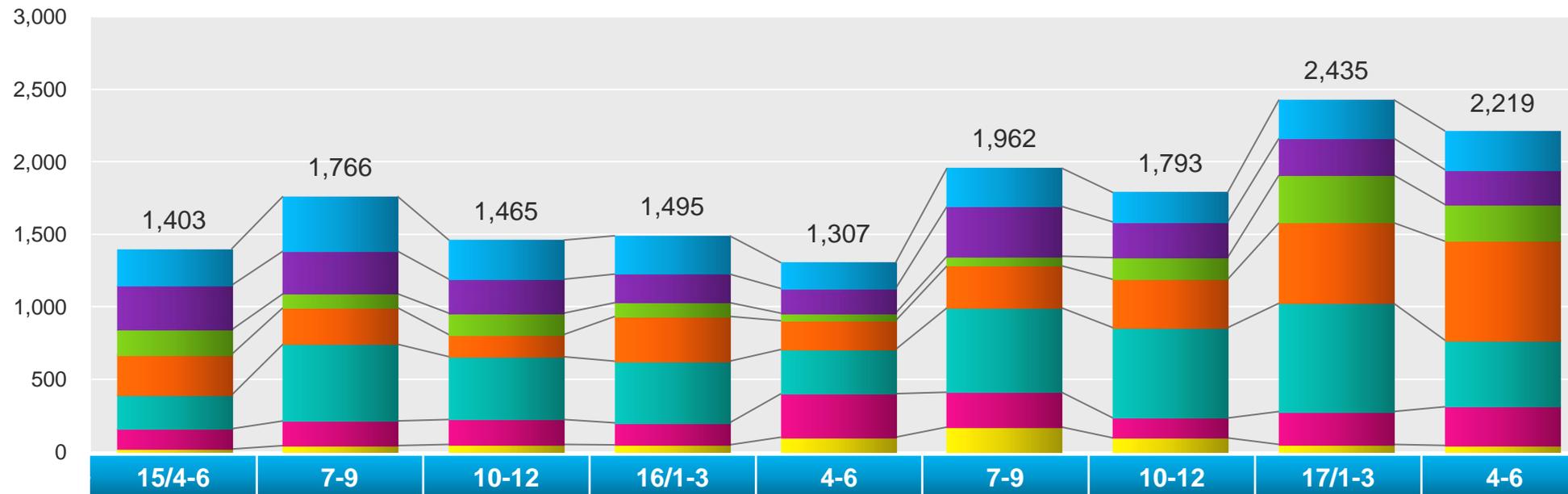
売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

SPE部門 地域別売上高

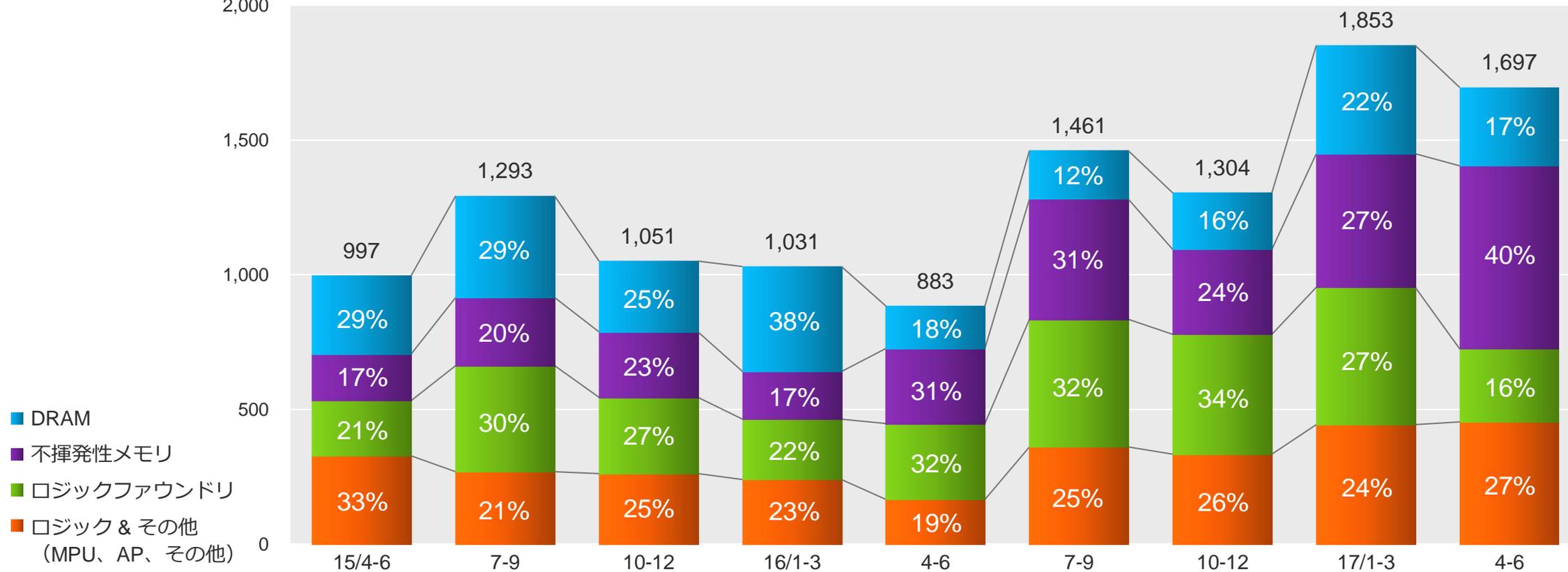
(億円)



	15/4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6	7-9	10-12	17/1-3	4-6
■ 日本	250	378	270	264	178	264	203	266	267
■ 北米	307	294	234	197	170	344	246	254	240
■ 欧州	170	96	148	95	52	66	150	329	253
■ 韓国	281	252	152	309	198	290	333	555	683
■ 台湾	231	529	433	425	305	582	623	747	458
■ 中国	140	170	172	152	300	240	137	227	267
■ 東南アジア・他	21	45	53	50	103	173	98	53	46

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比

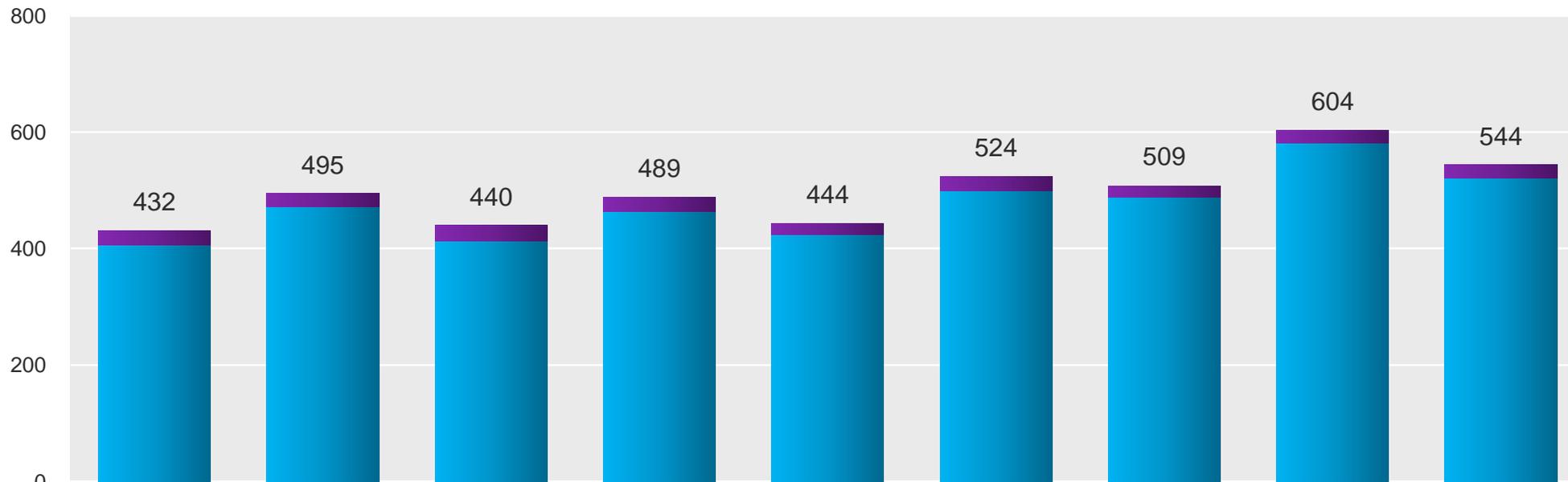
(億円)
2,000



韓国のNAND向けが増加
台湾のファウンドリおよびDRAMが減少

フィールドソリューション売上高

(億円)

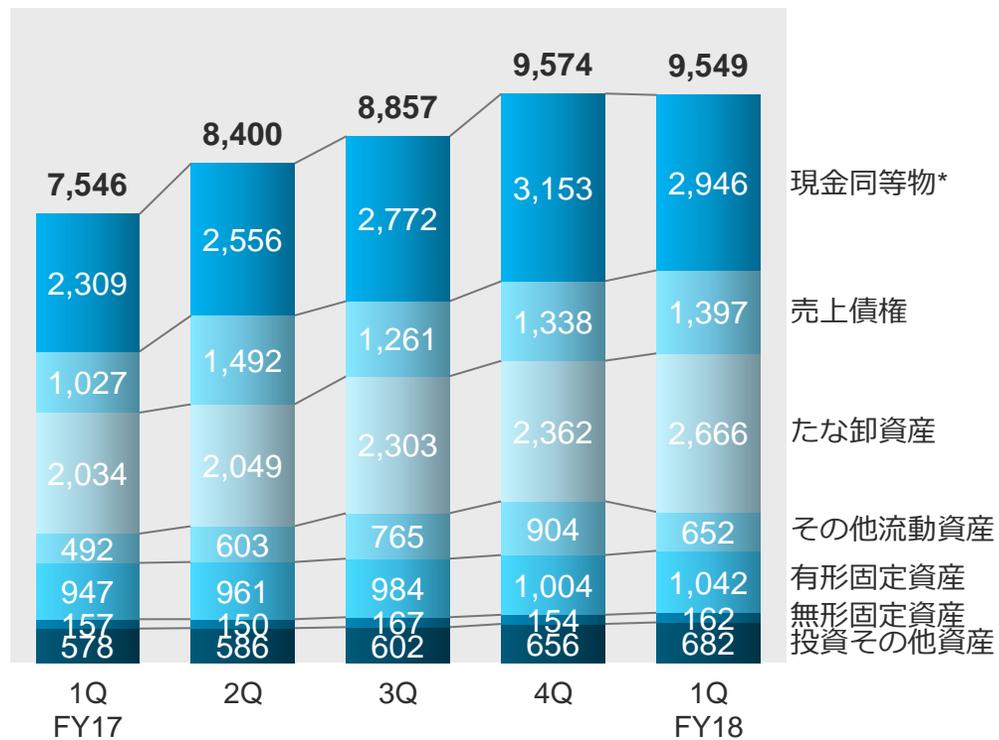


	15/4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6	7-9	10-12	17/1-3	4-6
SPE売上高	406	472	413	464	424	500	488	581	522
FPD売上高	25	23	27	24	20	24	20	22	22

貸借対照表

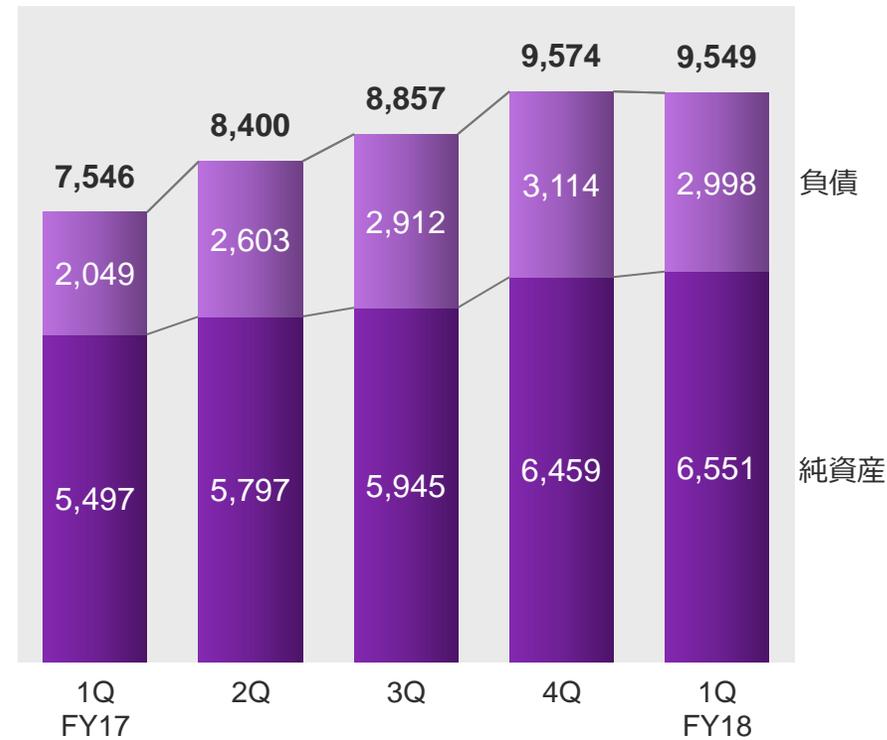
資産

(億円)



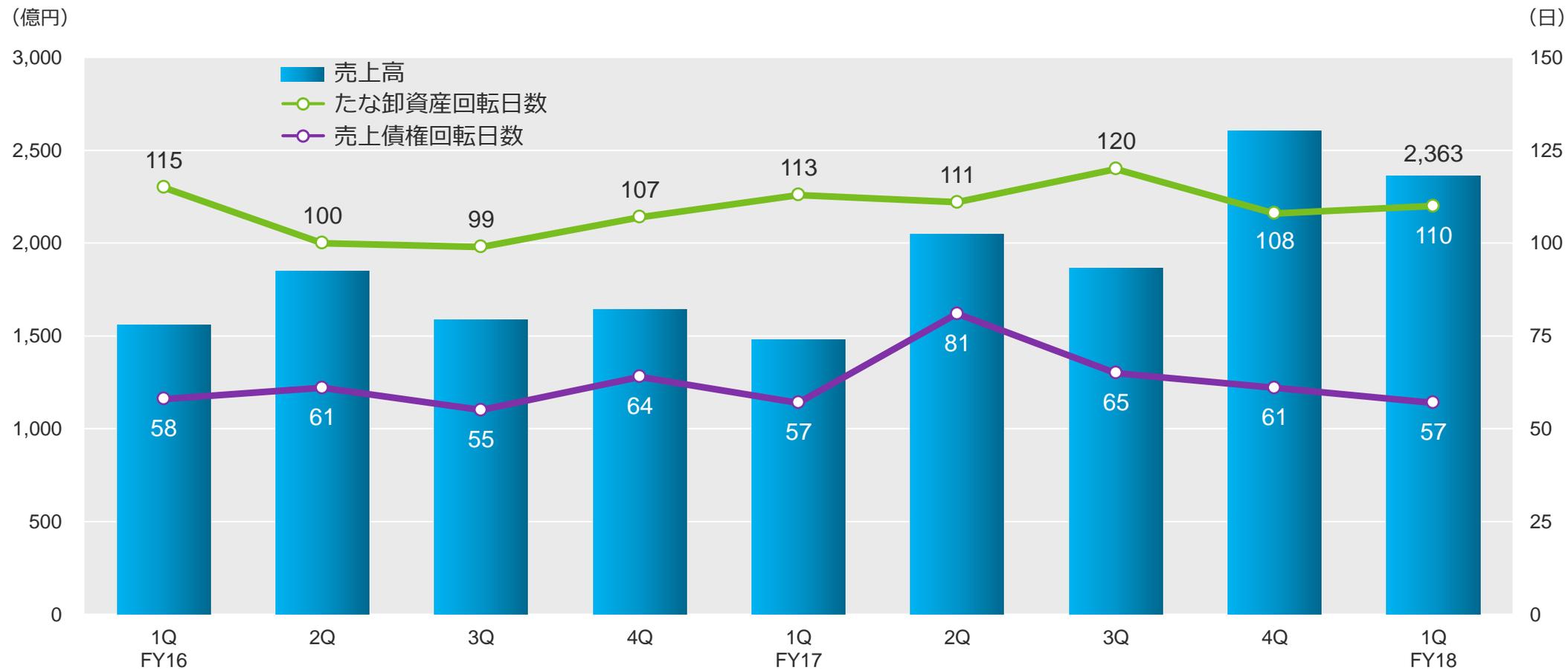
負債・純資産

(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

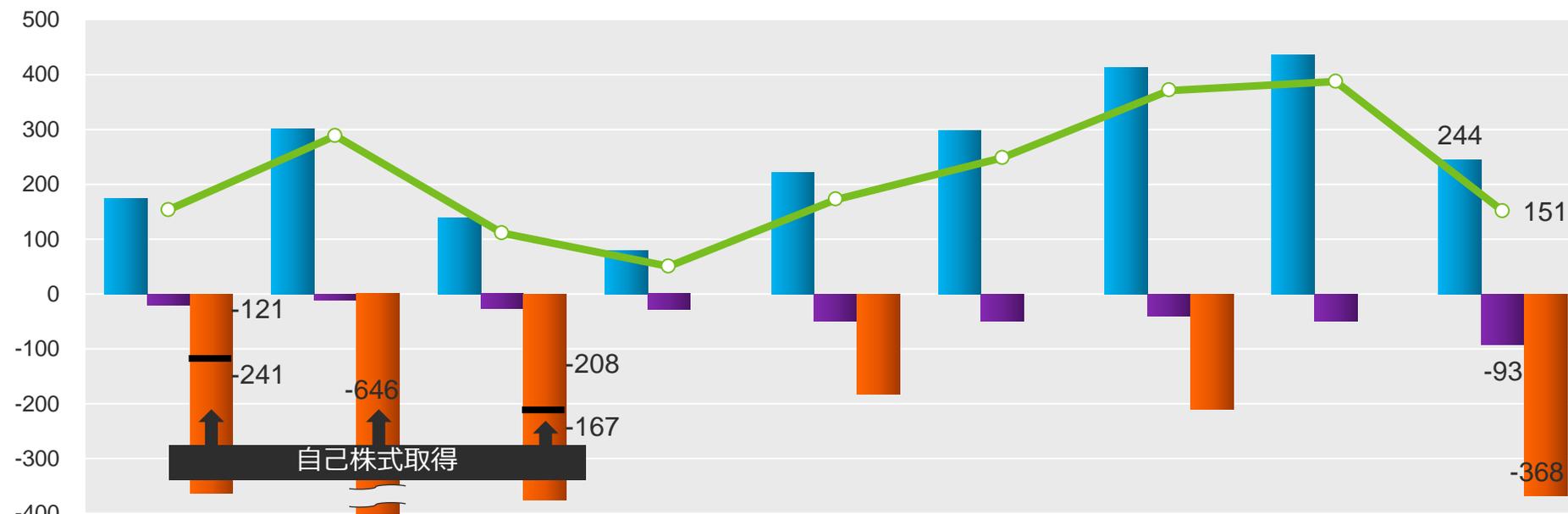
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)



	1Q FY16	2Q	3Q	4Q	1Q FY17	2Q	3Q	4Q	1Q FY18
■ 営業キャッシュ・フロー	173	301	138	79	221	298	413	436	244
■ 投資キャッシュ・フロー*	-20	-12	-27	-29	-49	-49	-41	-49	-93
■ 財務キャッシュ・フロー	-363	-646	-375	0	-183	0	-210	-0	-368
● フリーキャッシュ・フロー**	153	288	111	50	172	248	371	387	151
手元資金残高***	2,989	2,607	2,338	2,366	2,309	2,556	2,772	3,153	2,946

* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

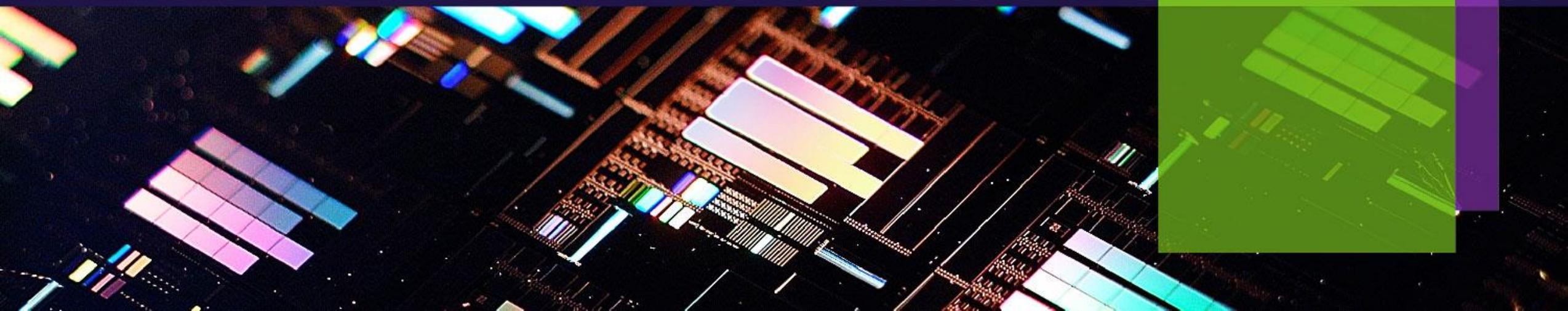
** フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*** 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

事業環境および業績予想

2017年7月27日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



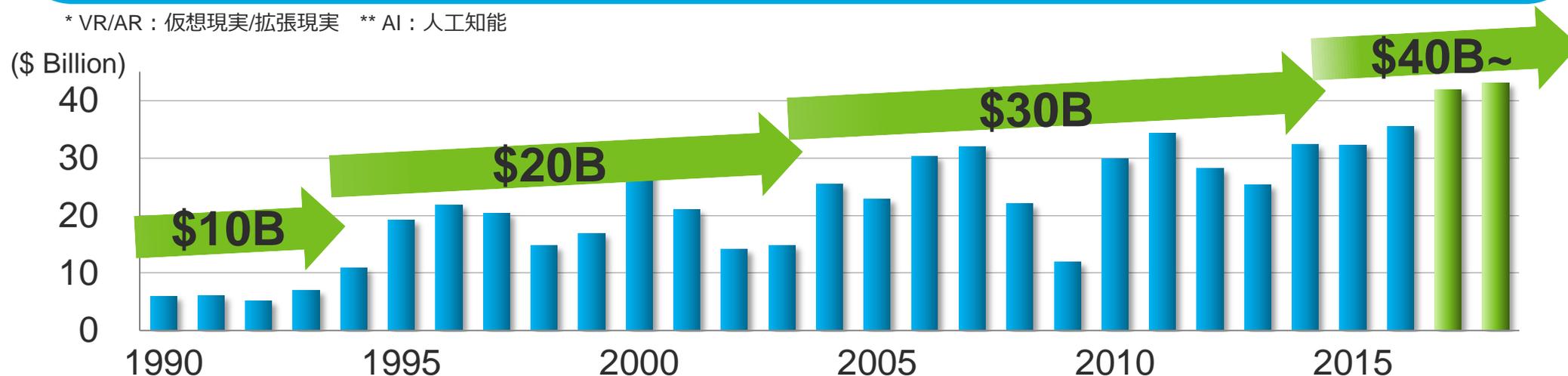
半導体前工程製造装置(WFE)市場の展望

将来の成長ドライバー

PC・インターネット・モバイル
+
VR/AR*・IoT・AI**・機械学習
ビッグデータ・自動運転・個別化医療

WFE市場は
\$40B以上に成長
先端ロジック・メモリ向けともに
投資拡大

* VR/AR : 仮想現実/拡張現実 ** AI : 人工知能



半導体用途の広がりにより、装置市場は一段上のフェーズへ

事業環境（2017年7月時点での見方）

▶ 半導体設備投資

CY2017の半導体前工程製造装置(WFE)*の設備投資額は、次世代3D NANDおよび先端ノード向けロジック投資の立ち上がりにより、前年比10%以上の成長を予想

▶ FPD設備投資

CY2017のTFTアレイ工程**向けのFPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資の継続と第10.5世代の立ち上がりにより、前年比30%程度の増加を見込む

装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が加速

* 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

** TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2017 アプリケーション別の市場成長と事業機会

- NAND：前年比30%程度の市場成長を予想
 - 牽引役：データ通信量増加に伴うデータセンタ向けSSD需要
 - 設備投資：6X/7X層数世代向けが7割、2017年末に月産70万枚の3D NAND生産設備を見込む
 - 事業機会：市場拡大とシェア向上、次世代9X/12X層数世代での工程拡大に注力
- DRAM：5-10%の増加
 - 牽引役：モバイルの平均搭載容量は前年比25%増加、サーバも40%増加
 - 設備投資：1Xnm世代向け設備投資が6割
 - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- ロジック/ファウンドリ：同水準を予想
 - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
 - 設備投資：最先端10/7nm世代向けが7割
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

2018年3月期 第1四半期 事業進捗

- SPE注力分野（エッチング、成膜、洗浄装置）の事業戦略は計画通り進捗
 - CY2017は注力3装置分野のすべてにおいてシェア向上を見込む
- FPD製造装置
 - 第10.5/第11世代におけるリーディングポジション確立
- 宮城工場（エッチング装置）の生産能力を、CY2019までに2倍に増強（今期の全社の設備投資予定 420億円に変更なし）
 - 現在建設中の新物流棟により生産効率を向上
 - 工場内の生産ラインを現在の2倍に増強



プラズマエッチング装置
Tactras™



東京エレクトロン宮城

2018年3月期 業績予想

2018年3月期 業績予想 (2017/4/28発表から変更なし)

(億円)

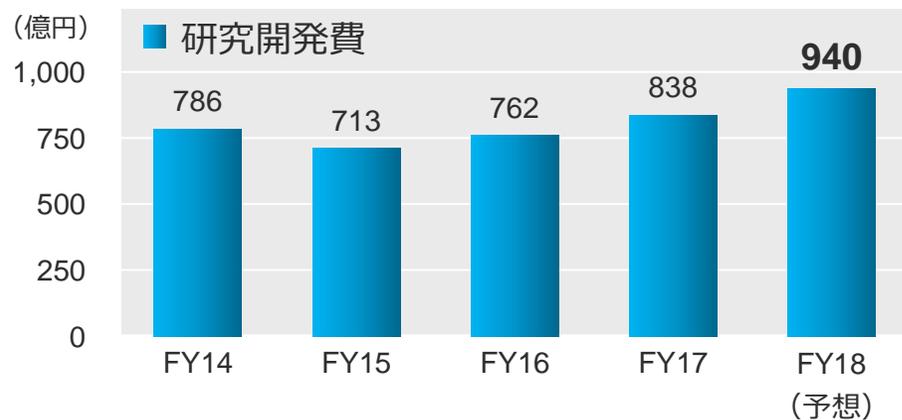
	FY2017 (実績)	FY2018 (予想)			
		上期	下期	通期	対前年増減
売上高	7,997	4,800	5,000	9,800	+22.5%
SPE	7,498	4,510	4,590	9,100	+21.4%
FPD	493	290	410	700	+41.7%
売上総利益 下段：売上総利益率	3,222 40.3%	2,020 42.1%	2,100 42.0%	4,120 42.0%	+897 +1.7pts
販管費	1,665	980	980	1,960	+294
営業利益 下段：営業利益率	1,556 19.5%	1,040 21.7%	1,120 22.4%	2,160 22.0%	+603 +2.5pts
税前利益	1,491	1,040	1,120	2,160	+668
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,152	790	840	1,630	+477
1株当たり当期純利益 (円)	702.26	481.48	511.96	993.44	+291.18

市場成長以上の売上拡大、2期連続の過去最高益を見込む

SPE: 半導体製造装置、FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

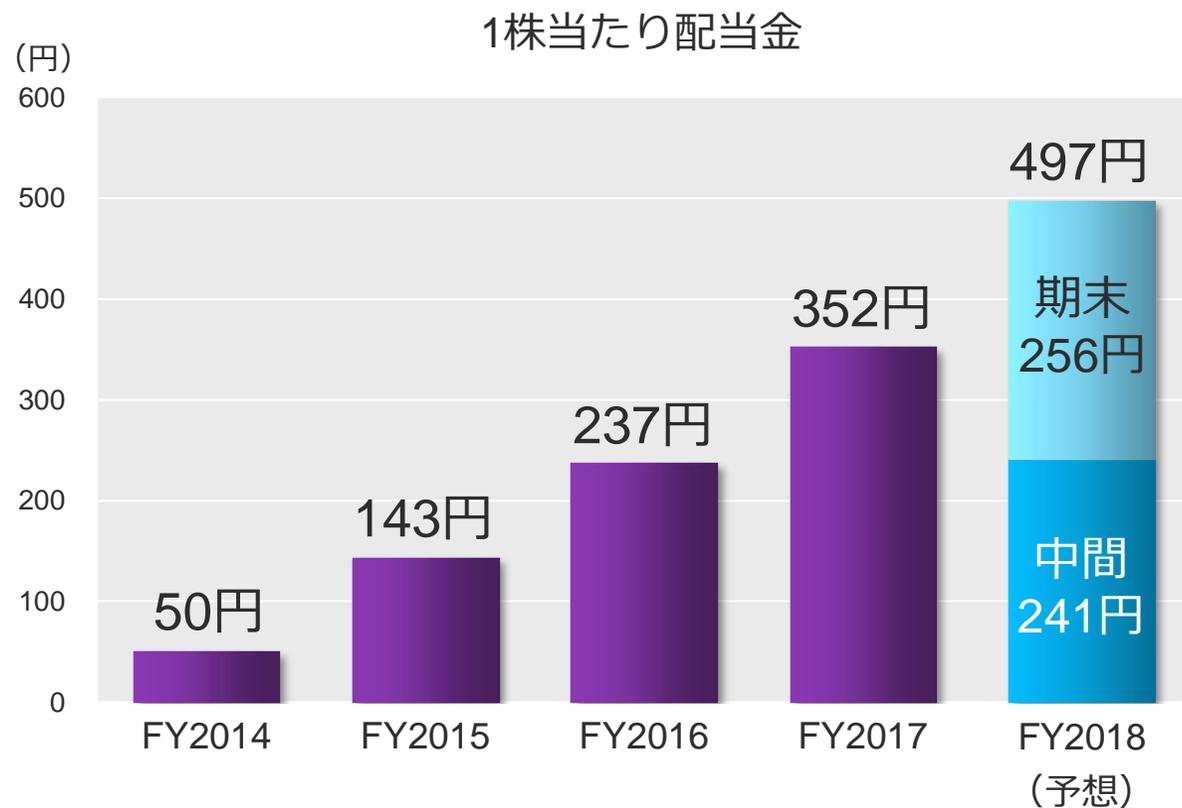
研究開発費・設備投資計画（2017/4/28発表から変更なし）

- 開発費 940億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 420億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 240億円



装置市場の新たなフェーズに向けた積極的な先行投資を予定

2018年3月期 配当予想 (2017/4/28発表から変更なし)



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、前期比40%以上の増配を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON